

上海概伦电子股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将“2025 年行动方案的实施进展及评估情况”和“2026 年主要措施”报告如下：

一、专注公司经营，持续提升核心竞争力

概伦电子作为国内首家 EDA 上市公司，是关键核心技术具备国际市场竞争力的 EDA 领军企业。2025 年度，公司实现营业收入 48,367.06 万元，较上年度增长 15.41%；实现主营业务收入 47,633.87 万元，较上年度增长 14.19%。其中，EDA 软件授权业务继续保持快速增长，实现营业收入 31,393.92 万元，同比增长 22.05%，占公司主营业务收入的 65.91%，同比增加 4.24 个百分点。公司深耕行业前沿，精准洞察下游客户需求迭代趋势，主动适配市场变化、应对行业挑战，通过优化服务模式、强化产品价值输出，在客户拓展与单客价值提升上实现双重突破。报告期内，公司合作客户规模持续扩容，发生交易的客户总数达到 165 户，与此同时，单客户平均收入贡献稳步攀升，达到 288.69 万元，彰显了公司产品与服务的核心竞争力及市场认可度。

依托持续高强度的研发投入与技术积累，公司在 EDA 核心技术攻关与产品化落地方面取得一系列标志性成果，综合技术实力与行业影响力获得权威认可。公司 EDA 软件相关产品及技术获得多项行业重磅奖项，其中 SDEPT[™]自动化模型提取平台荣获“中国芯”EDA 专项“技术创新奖”，NanoYield[™]良率分析解决方案斩获“中国芯”EDA 专项“产品革新奖”及 2025 全球电子成就奖“年度 EDA

产品奖”；公司还获评 2025 年上海市“制造业单项冠军企业”，彰显在 EDA 领域的技术实力与行业引领地位，也从资本市场视角提供了稳定的价值预期。

1. 加快研发进度，提升产品多样性

2025 年度，公司研发投入合计 3.26 亿元，同比增长 13.04%；研发投入占营业收入的比例达到 67.48%，积极担当新质生产力。公司持续的高水平研发投入有力推动了产品创新工作：

在 EDA 软件授权业务方面，公司聚焦 EDA 软件核心业务，持续推进产品迭代升级，夯实核心竞争力，展现出稳健的业务发展态势。期间，公司发布了一系列新产品，包括针对先进工艺研发的新一代自动化建模平台、针对标准单元库和 SRAM 库特征化的全新产品系列、更高性能和更全场景覆盖的电路仿真和分析解决方案等，覆盖从晶体管到单元、模块、全芯片级和封装级等全流程应用，进一步丰富产品矩阵，产品市场适配性与竞争力持续提升。产品与技术的持续突破，获得行业权威认可，进一步印证了公司的技术实力与行业地位，为业务长期发展奠定坚实基础。公司 EDA 软件相关产品及技术获得多项行业重磅奖项，其中 SDEP™自动化模型提取平台荣获“中国芯”EDA 专项“技术创新奖”，NanoYield™良率分析解决方案斩获“中国芯”EDA 专项“产品革新奖”及 2025 全球电子成就奖“年度 EDA 产品奖”；公司还获评 2025 年上海市“制造业单项冠军企业”，彰显在 EDA 领域的技术实力与行业引领地位，也从资本市场视角提供了稳定的价值预期。

在半导体器件特性测试系统业务方面，2025 年度，虽面对行业周期波动及市场竞争等多重挑战，该业务始终坚守核心业务阵地，聚焦维稳发展、筑牢核心市场份额，以技术创新为核心驱动力，持续加大新品研发与现有产品优化力度，积极应对市场变化、强化核心竞争力。针对核心产品，98 系列低频噪声测试系统完成多轮性能迭代，进一步巩固了其在全球半导体低频噪声测试领域的领先优势，成为行业内标杆性测试设备；2025 年 3 月 SEMICON 展会期间，公司重磅推出先进宽带噪声分析仪 9812HF 新品，该设备兼具宽量程、宽阻抗测量特性，搭载国际领先的高带宽高精度测试分析技术，可全面覆盖 1/f 噪声、热噪声等各类噪声测试场景，精准匹配先进工艺制程优化、器件建模验证等全流程应用需求，上市后迅速获得海内外客户的广泛关注与积极评价。此外，公司 FS800 器件参数分析

仪凭借自主研发的模块化混合架构，高精度、高灵活性的优势，成功中标南京大学半导体电子测量系统采购项目，为高校半导体前沿科研工作提供了全方位、高性能、精准高效的测试解决方案，进一步夯实核心份额、为后续发展筑牢基础。

在技术开发解决方案业务方面，公司持续加大技术开发解决方案的研发与推广力度，通过技术创新、场景拓展、生态合作等举措，持续释放增长潜力。公司先后在多个行业重要展会及论坛中展示技术开发解决方案创新成果：在 2025 慕尼黑电子展上，公司推出覆盖“设计-制造-验证”全流程的车规级 DTCO 解决方案，通过自主研发的测试平台、车规 PDK 定制开发、可靠性指标深度植入设计流程、制造端 SPICE 模型与设计工具联动，已助力多家全球领先车芯厂商及代工厂，推动汽车电子从“功能安全”向“失效免疫”的技术突破；在格罗方德（GlobalFoundries）2025 技术峰会上，公司作为长期 EDA 合作伙伴受邀参会，围绕先进工艺节点设计方法学及制造类 EDA 工具协同优化进行深入交流，展示公司在全球晶圆代工生态中的技术影响力。同时，公司持续丰富解决方案矩阵，聚焦技术开发解决方案的系统性升级，优化全流程服务能力，结合不同行业客户需求，完善场景化解决方案，进一步提升适配能力与服务水平，推动技术开发解决方案业务规模化发展。

2026 年，公司将持续加大研发投入，以技术创新为核心驱动力，重点融入 AI 驱动 EDA 发展理念，依托 AI 技术优化 EDA 核心算法、提升工具精度与研发效率，推动业务高质量发展。聚焦 EDA 核心技术研发和产品升级，强化 IP 产品矩阵与 EDA 工具的协同适配能力，优化研发资源配置，吸引并培养高素质技术人才，提升研发效率；同时联动国内外科研机构，通过协同创新加速新技术落地，紧跟云计算、AI 等前沿技术在 EDA 领域的应用趋势，提升产品核心竞争力，巩固国内 EDA 市场领先地位。

2. 坚持国际化战略，强化全球市场竞争力

2025 年，公司来自境内的主营业务收入 36,315.12 万元，较上年度增长 19.38%，占公司主营业务收入的比例为 76.24%，同比增加 3.31 个百分点，境内市场竞争力进一步提升。公司始终坚持国际化战略，重视国际市场的开拓和发展，实现来自境外市场的主营业务收入为 11,318.76 万元，面对全球经济格局深度调整、外部环境复杂多变的形势，公司海外业务整体保持稳健运行，发展基础持续巩固。

2026年，公司将以品牌建设为核心牵引，依托专业的市场推广体系，全面构建多层次、高标准的市场拓展格局。公司将积极参与全球各大行业顶级展会与高端论坛，主动举办系列技术交流会与产业研讨会，精准捕捉 EDA 及芯片产业前沿动态与市场趋势。通过深化与产业链上下游的协同合作，全方位提升产品曝光度与行业影响力，持续强化在资本市场及半导体领域的品牌美誉度。同时，公司将坚持产品与服务双轮驱动，持续优化品质与服务体验，以卓越的品牌形象为高质量发展筑牢根基。

在市场与销售层面，公司将实施策略升级，驱动业务规模与市场份额双提升。一方面，强化销售与技术服务团队的专业化建设，构建高效的客户服务体系。在稳固现有客户合作关系的基础上，推行多元化销售战略，积极拓展新兴客户群体，加大对高增长领域的资源投入，快速提升市场占有率。另一方面，深入梳理与深耕客户资源，聚焦头部客户与优质客户，通过定制化解决方案与全周期高效服务，深度绑定客户关系，持续增强客户粘性，推动产品市场覆盖度与渗透率的全面提升。

3. 推进募投项目建设和治理结构改善，增强可持续发展能力

(1) 募投项目建设情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2025 年 12 月 22 日，公司首次公开发行股票募投项目中的“建模及仿真系统升级建设项目”、“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”、“研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对上述募投项目予以结项。截止募集资金专户销户日，募集资金节余金额合计 16,606.81 万元（包含募集资金产生的银行存款利息），已永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司首次公开发行股票募集资金的规范投入与高效使用，为核心技术研发、产品体系升级及研发能力建设提供了坚实资金保障，有力支撑了公司在建模仿真、设计工艺协同优化、存储 EDA 解决方案等关键领域的技术突破与能力提升，对公司完善研发布局、强化核心竞争力、推动业务持续高质量发展具有重要意义。

本次相关募投项目顺利结项，标志着既定建设目标如期达成，募集资金使用成效显著。

对于本次结项形成的节余募集资金，公司将坚持审慎规划，将节余资金永久补充流动资金并统筹用于日常生产经营、技术创新、市场拓展及产业链协同等核心业务领域，进一步优化公司资金结构、提升资金使用效率，为公司实现长期可持续发展提供稳定的资金支撑，切实维护公司及全体股东的长远利益。

(2) 治理架构完善情况

2025年，公司先后完成多项治理结构优化工作：首先，公司完成第二届董事会独立董事补选工作，选举张卫先生为公司独立董事，其同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，任期至第二届董事会任期届满之日止；其次，公司对董事会规模进行调整，董事会人数由7名增加至9名，相应增设1名董事及1名职工董事，并通过职工代表大会选举李石松先生为公司第二届董事会职工董事，其任期至第二届董事会任期届满之日止。此外，公司按照法定程序取消监事会设置，原由监事会行使的相关职权改由董事会审计委员会履行，原监事职务相应免除，《监事会议事规则》同步废止。

报告期内公司对治理结构进行系列优化调整，主要基于公司经营规模持续扩大、业务布局不断深化及长期战略发展需要。为进一步提升董事会决策效率、强化战略引领与专业审议能力，公司适当扩大董事会规模，优化董事构成，引入职工代表参与治理，使决策机制更贴近经营实际、更贴合产业发展需求。同时，结合公司治理实践与监管导向，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关监督职能，有利于精简治理架构、理顺权责运行机制，提升内部监督与风险管控效能。通过补选独立董事、优化董事会各专门委员会设置，进一步强化专业决策、提名及薪酬考核等职能，完善法人治理结构，提升公司规范化运作水平，更好地维护公司及全体股东利益，为公司持续高质量发展提供坚实的治理保障。

2026年，公司将持续完善公司治理体系，全面强化内部控制与精细化管理水平。公司将进一步推进信息化与数字化建设，依托现代化管理工具提升资源配置效率与运营管控能力。在财务管理层面，持续深化全面预算管理与成本管控，优化资金使用效率，保障财务结构稳健运行。同时，不断健全内部审计与风险防控机制，聚焦重点业务、关键流程与高风险环节实施全流程监督，完善内控体系与

合规管理，筑牢风险防范屏障，持续提升公司规范化运作水平，为公司战略落地与高质量可持续发展提供坚实保障。

4. 坚持人才兴企战略，践行高质量发展理念

人才作为技术创新与业务发展的核心驱动力，公司始终坚持人才兴企战略，于 2025 年内完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，以及首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属工作，合计归属限制性股票总数达 1,373,408 股，涵盖董事、高级管理人员及其他需激励的核心员工 100 余名，充分体现了公司对各类核心人才的重视与激励导向，为人才队伍建设注入强劲动力，推动人才工作实现稳步进展。

两次股权激励归属的顺利实施，不仅以股权为纽带深度绑定核心人才与公司利益，激发员工积极性与创造力，更助力公司实现人才队伍的稳定与优化。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工总量为 608 人；在研发人员方面，研发人员总数达到 445 人，占公司总人数的比例达到 73.19%；在人员结构方面，研发人员结构保持高水准，硕士及以上学历人员占比达 77.75%，40 岁以下年龄段人员占比达 78.20%，形成了一支高素养、年轻化的核心人才队伍。同时，公司借助股权激励的激励效应，重点引入 AI 算法、芯片设计、半导体工艺、IP 等领域高端人才与技术专家，同步完善内部培训体系，全面提升员工专业技能与综合素质，为 EDA 全解决方案的迭代升级与业务高速增长提供坚实人力支撑。

二、紧抓行业机遇，推动公司发展成为国内 EDA 平台型企业

2025 年，公司坚定贯彻“内生发展+外延并购”双轮驱动战略，围绕 EDA 产业生态布局持续推进并购重组与产业投资，通过资本运作与产业资源整合，不断完善业务链条、强化技术协同，为构建国内 EDA 平台型企业奠定坚实基础。

1. 并购重组

2025 年 4 月 12 日，公司公告拟通过发行股份及支付现金的方式收购锐成芯微 100% 股权及纳能微 45.64% 股权。锐成芯微作为高端半导体 IP 授权及芯片定制服务领域的创新型企业，拥有覆盖全球 30 多家晶圆厂、4nm~180nm 等多种工艺类型的一千多项物理 IP，为汽车电子、工业控制、物联网、无线通信等领域提供以物理 IP 技术为核心竞争力的解决方案。交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成

为公司全资子公司，助力公司构建“EDA 工具+半导体 IP”双引擎模式，打通从芯片前端工具支撑到后端赋能的全链条能力，加速 EDA 工具研发与客户导入，有望为公司带来显著业绩增量。

2. 产业投资

报告期内，公司积极布局产业基金投资，进一步整合 EDA 产业链优质资源，寻找高技术含量、高成长性的投资标的，推动业务拓展与技术合作，实现资本运作与产业发展的深度融合，为公司长期战略布局提供有力支撑。

2025 年 7 月 24 日，公司与上海国有资本投资有限公司、上海芯合创正式签署《战略合作框架协议》，三方本着互信互利、共赢发展的原则，围绕 EDA 产业整合、产业投资合作、人才战略合作等方面建立长期全面的战略合作关系，协同构建 EDA 产业投资生态体系，助力公司加快 EDA 产业布局、完善产品链，进一步提升行业影响力与核心竞争力。

作为上述战略合作的落地项目之一，2025 年 8 月，公司与上海芯合创联合投资上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临科芯伦”），专注于 EDA 软件等行业及相关领域的股权投资。其中，公司作为有限合伙人首期出资 19,270.89 万元，持有临科芯伦约 14.4120% 的合伙份额；2026 年 4 月，公司与上海芯合创在前期出资基础上对临科芯伦进行共同增资，本次增资完成后，公司对临科芯伦的认缴出资金额增加至 25,000 万元，持有临科芯伦约 15.3994% 的合伙份额。截至本报告披露日，临科芯伦已完成出资人民币 131,989.68 万元受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的深圳鸿芯微纳技术有限公司 38.74% 股权事项。

依托并购重组实现核心资源快速集聚，依托产业投资与战略合作拓宽产业生态边界，公司有效打通了技术、产品、市场与资本的协同通道。未来，公司将继续以战略目标为引领，深化资本运作与产业运营的深度融合，持续优化产业布局，不断提升综合竞争实力与行业影响力，为实现高质量可持续发展注入持久动力。

三、聚焦价值创造，打造概伦电子资本市场品牌美誉度

在市值管理与股东结构优化方面，公司 2025 年多措并举、稳步推进，构建起规范、高效的资本运作体系，实现股东价值与公司发展的双向赋能。

1. 信息披露提质高效

公司凭借规范的运作与高质量的信息披露，获得上海证券交易所 2024-2025 年度信息披露“A 级”，并实现上市以来连续 3 年在沪市上市公司信息披露工作评价中斩获 A 级，充分体现了监管层对公司合规运作能力、信息披露质量的高度认可，也为维护资本市场信心、保障股东知情权奠定了坚实基础。

2. 股东结构持续优化

公司通过股东协议转让方式持续优化股权结构，引入优质战略投资者，增强股权稳定性与战略协同效应。2025 年 10 月，公司相关股东向上海芯合创协议转让公司 5.00% 股份，并办理完毕股份过户登记手续；2026 年 3 月，公司相关股东向上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）转让公司 5.00% 股份，并办理完毕过户登记手续。截至本报告披露日，上海科创集团、上海芯合创均成为公司持股 5% 以上股东。上述两次协议转让的受让方均承诺 18 个月锁定期，有效保障了股权结构的稳定性。战略投资者的引入优化了公司股东构成，强化了国有资本赋能与产业战略协同，为公司长期稳健发展注入新动能。

3. 利润分配积极回馈

2025 年，为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司制定并实施了 2024 年度权益分派实施方案：按照扣除回购专用账户的股份 1,300,070 股后实际参与分配的股本总数为 433,877,783 股，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 13,016,333.49 元（含税）。自 2021 年底上市以来，公司持续落实利润分配制度，先后三次实施符合公司实际情况的现金分红方案，累计派发现金红利金额达 5,205.87 万元（含税）。

4. 股份回购稳健实施

2024 年 1 月，公司启动实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。截至 2025 年 1 月 28 日，公司本次股份回购计划实施完毕，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额

20,007,759.10 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），有效维护了广大投资者利益，增强了投资者对公司的投资信心，充分满足投资者的回报需求。

5.投资者交流深化拓展

2025 年，公司持续加强投资者交流，投资者关系力度进一步提升：组织或参加各类投资者交流活动 100 余场，覆盖投资者超 500 人次；公司举办 4 期 3 场业绩说明会，积极融合半导体、软件行业专场优势，垂直触达广大投资者群体；举办重大资产重组事项专项投资者说明会，及时回应市场关切，保障投资者知情权与参与权，进一步夯实投资者关系管理和保护工作常态化、高质化基础。同时，公司还以现场接待、网络会议、电话会议等多种形式组织投资者交流活动；全年定期发布投资者关系记录表，与投资者共同分享互动问答；积极回复交易所 E 互动问题，积极接听投资者专用热线电话。

报告期内，公司董事、总裁杨廉峰受邀参加陆家嘴金融沙龙，以《国产 EDA 发展和集成电路生态建设》为题做了主旨发言，与科创基金、产业资本、领军企业等专家学者，共同聚焦集成电路产业，探讨耐心资本如何支持经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业高质量发展，助推集成电路产业更好强链、补链、延链，有效提升公司在资本市场的曝光度与机构认可度，助力投资者关系工作开展。

公司将坚定不移地秉持长期主义发展战略，紧紧抓住 EDA 国产替代的黄金发展契机，以完成相关并购项目及后续全面整合为重要抓手，在全力推进自主研发的 EDA 核心算法与工具链技术创新、实现关键技术突破的基础上，紧密围绕“头部客户”，持续强化团队建设。紧紧锚定提升 EDA 工具的精度与效率、拓展对先进制程工艺的支持、增强与本土集成电路产业生态的适配性等重点发展方向，推进公司资源的优化配置与精准聚焦；注重 EDA 产品技术的平台化构建、流程的规范统一与标准化执行，强化企业精细化管理和专业人才队伍建设，通过并购整合实现资源互补、能力跃升，持续推动公司业务规模不断拓展、实力持续增强，助力公司加速向“EDA+IP 一站式综合解决方案平台”转型，夯实国内先进工艺突破核心支撑底座地位。

以上内容是基于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案实施情况而作出的判断及评估，和在 2025 年度方案基础上进一步优化的 2026 年度“提质增效

重回报”专项行动方案。后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，紧密结合自身经营实际与投资者关切重点，不断优化完善行动方案，稳步推进各项举措落地见效。本报告所涉及的公司发展规划、战略部署等内容，均属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者审慎判断，注意防范相关投资风险。

如有对本报告涉及相关内容或投资者关系事宜咨询，欢迎您按如下方式与公司取得联系：

投资者关系热线：+86-021-61640095

投资者关系邮箱：IR@primarius-tech.com

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年4月15日